

中信证券股份有限公司

关于杭州士兰微电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）2018 年度非公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对士兰微 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2017〕2005 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,505,709 股。根据询价情况，公司最终确定向 6 名特定对象发行普通股（A 股）64,893,614 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.28 元，共募集资金总额为 731,999,965.92 元。扣除承销费、保荐费 25,440,000.00 元（其中进项税额 1,440,000.00 元）后的募集资金为 706,559,965.92 元，已于 2018 年 1 月 3 日汇入公司在农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立的账号为 19033101040020262 人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 2,405,660.37 元后，公司本次募集资金净额 705,594,305.55 元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕1 号）。

2、募集资金使用计划及调整

（1）募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资金额	
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	-
其中：MEMS 传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	杭州经济技术开发区经济发展局杭经开经技备案（2017）5 号、6 号
MEMS 传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	金堂县经济科技和信息化局金经信技改备案（2017）1 号
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	杭州市滨江区发展改革和经济局滨发改体改（2017）003 号
合计	80,253.00	80,000.00	-

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司按照项目的轻重缓急，将募集资金用于 MEMS 传感器芯片制造扩产项目、MEMS 传感器封装项目和 MEMS 传感器测试能力提升项目，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。其中，MEMS 传感器芯片制造扩产项目实施主体为公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称士兰集成公司）、MEMS 传感器封装项目实施主体为公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司），实施方式为募集资金到位后，公司利用募集资金对士兰集成公司、成都士兰公司进行增资。

（2）募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

1) 根据公司 2018 年 1 月 23 日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	70,559.43
其中：MEMS 传感器芯片制造	37,900.00	37,647.00	30,568.43

扩产项目			
MEMS 传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	20,000.00
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00
合计	80,253.00	80,000.00	70,559.43

2) 根据公司 2019 年 11 月 8 日第七届董事会第五次会议和 2019 年 11 月 25 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，基于产线升级、进一步提高募集资金使用效率等原因，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况对原募投项目的建设期、投资金额等进行调整，同时增加 8 吋芯片生产线二期项目和特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目作为新增的募集资金投资项目，具体调整情况如下：

单位：万元

原募投项目	总投资额	变更后募投项目	调整后募集资金投入金额	建设期
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	70,559.43	一、年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	30,559.43	由 2 年调整至 7 年
其中：MEMS 传感器芯片制造扩产项目	30,568.43	其中：MEMS 传感器芯片制造扩产项目	10,568.43	-
MEMS 传感器封装项目	20,000.00	MEMS 传感器封装项目	10,000.00	-
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	MEMS 传感器测试能力提升项目	9,991.00	-
-	-	二、8 吋芯片生产线二期项目	30,000.00	5 年
-	-	三、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	10,000.00	3 年
合计	70,559.43	-	70,559.43	-

其中，8 吋芯片生产线二期项目实施主体为公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称士兰集昕公司）、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目实施主体为公司孙公司成都集佳科技有限公司（以下简称集佳科技公司）。

3、募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	70,559.43
截至期初累计发生额	项目投入	B1	70,237.65
	利息收入净额	B2	1,591.00
本期发生额	项目投入	C1	358.34
	利息收入净额	C2	16.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	70,595.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,607.56
部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金[注]		E	212.83
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	1,358.17
实际结余募集资金		G	1,358.17
差异		H=F-G	-

注：系集佳科技公司特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目建设本期结项，剩余募集资金 212.83 万元（含利息收入净额）永久补充流动资金

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 248,000,000 股，每股发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，坐扣承销费、保荐费（不含税）4,056.60 万元后的募集资金为 491,943.40 万元，已于 2023 年 11 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）637.29 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕603 号）。

2、募集资金使用计划及调整

（1）募集资金投资项目投资金额及募集资金使用计划

公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资净额	
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	钱塘区杭州钱塘新区行政审批局 2204-330114-89-02-524827
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	厦门市海沧区工业和信息化局 2207-350205-06-02-858369
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	金堂县发展和改革局川投资备（2210-510121-04-01-381195）FGQB-0490 号
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	-
合计	1,005,000.00	650,000.00	-

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司按照项目的轻重缓急，将募集资金用于年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、SiC 功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期），不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。其中，年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目实施主体为公司控股子公司士兰集昕公司、SiC 功率器件生产线建设项目实施主体为公司控股子公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称厦门明镓公司）、汽车半导体封装项目（一期）项目实施主体为公司控股子公司成都士兰公司，实施方式为募集资金到位后，公司利用募集资金对士兰集昕公司、厦门明镓公司、成都士兰公司进行增资。

（2）募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

根据公司 2023 年 11 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
------	------	-------------	-------------

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	390,000.00	300,000.00	160,000.00
SiC 功率器件生产线建设项目	150,000.00	75,000.00	75,000.00
汽车半导体封装项目（一期）	300,000.00	110,000.00	110,000.00
补充流动资金	165,000.00	165,000.00	146,306.11
合计	1,005,000.00	650,000.00	491,306.11

3、募集资金使用和结余情况

2023 年度，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	491,306.11	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	190,624.70
	利息收入净额	C2	565.69
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	190,624.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	565.69
应结余募集资金	E=A-D1+D2	301,247.10	
实际结余募集资金	F	301,523.54	
差异[注]	G=E-F	-276.44	

注 1：差异系公司尚未支付的发行费用 125.47 万元以及公司使用自筹资金预先支付尚未置换的发行费用 150.97 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，发行费用中尚有 89.62 万元未支付。

注 2：2024 年 2 月 1 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案。截至 2024 年 3 月 31 日，使用自筹资金预先支付的发行费用已全部置换完毕。

二、募集资金管理情况

（一）2018 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2023〕193号)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并于2018年1月23日与东方证券承销保荐有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司对以增资方式收到的募集资金,也实行了专户存储,公司分别和士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司于2018年2月、2018年2月、2019年12月、2020年9月与东方证券承销保荐有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州市东新支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、中国农业银行股份有限公司金堂县支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司在募集使用时已严格遵照执行。

根据公司于2022年12月21日披露的《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》,公司更换了持续督导保荐机构,东方证券承销保荐有限公司未完成的持续督导工作由中信证券股份有限公司承担。公司与中信证券股份有限公司、各募投项目实施主体、银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司、士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司、集佳科技公司在募集使用时已严格遵照执行。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司及子公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	------	--------	----

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040020262	708.22	募集资金专户
士兰集成公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000826	0.33	募集资金专户
成都士兰公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	331066080018800024087	649.63	募集资金专户
士兰集昕公司	中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033101040025451	-	募集资金专户
合计			1,358.17	-

(二) 2023 年向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2023 年 12 月 11 日，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行在杭州签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 3 日，公司及厦门明镓公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行厦门市分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024 年 1 月 19 日，公司及成都士兰公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、厦门明镓公司、成都士兰公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	19033101040036623	250,841.30	募集资金专户
厦门明镓公司	国家开发银行厦门市分行	35200109000000000059	30,682.24	募集资金专户

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
成都士兰公司	国家开发银行四川省分行	51100100000000000625	20,000.00	募集资金专户
合计			301,523.54	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2018 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见附件 1 “2018 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表”。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(3) 募集资金结余及节余募集资金使用情况

募集资金投资项目“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”已于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目”予以结项，并将项目结余募集资金金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，将转出至自有资金账户，用于公司日常生产经营及业务发展。公司于 2023 年 5 月 17 号将结余资金转出永久补充流动资金 212.83 万元，并将募集资金账户销户。

2、公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 2023 年向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见附件 2 “2023 年向特定对象发行募集资

金使用情况对照表”。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目变更情况详见本专项核查意见之“一/（一）/2/（2）募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明”。

变更募集资金投资项目情况表详见附件3“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，士兰微公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发（2023）193号）的规定，如实反映了士兰微公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，士兰微2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定，士兰微对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 1、2018 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表
- 2、2023 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表
- 3、变更募集资金投资项目情况表

（以下无正文）

附件 1

2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：万元

募集资金净额				70,559.43		本年度投入募集资金总额				358.34		
变更用途的募集资金总额				40,000.00		已累计投入募集资金总额				70,595.99		
变更用途的募集资金总额比例				56.69%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	是	80,000.00	30,559.43	未作分期承诺	297.83	30,507.35	-52.08	99.83	2024 年 12 月	2023 年该项目实现销售收入 28,565.43 万元，实现销售毛利 2,000.60 万元，实现净利润 -2,554.85 万元	不适用	否
8 吋芯片生产线二期项目	是		30,000.00	未作分期承诺	0.90	30,236.17	236.17	100.79	2024 年 12 月	2023 年该项目实现销售收入 92,475.73 万元，实现销售	不适用	否

										毛利 14,123.19 万元，实现利润总额 9,880.60 万元		
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	是		10,000.00	未作分期承诺	59.61	9,852.47	-147.53	98.52	2022 年 12 月	2023 年该项目实现销售收入 31,804.04 万元，实现销售毛利 4,303.02 万元，实现净利润 2,696.34 万元	否[注]	否
合计	-	80,000.00	70,559.43		358.34	70,595.99			-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目建设期由 2 年调整至 7 年，详见本核查意见一/（一）/2、/（2）/2 之说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本核查意见三/（一）/1、/（3）之说明								
募集资金其他使用情况				无								

注：特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目预计正常生产年度新增净利润 4,460 万元，本期未达预计效益主要系本年度下游客户需求结构性调整，产品价格有所下降，同时原材料价格持续高位运行，成本较高，综合导致毛利率下降。

附件 2

2023 年向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2023 年度

金额：万元

募集资金净额				491,306.11		本年度投入募集资金总额				190,624.70		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				190,624.70		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目	否	300,000.00	160,000.00	未作分期承诺	-	-	-160,000.00	-	2024 年 12 月	2023 年该项目实现销售收入 8,655.97 万元, 实现销售毛利 3,250.11 万元, 实现利润总额 2,889.72 万元 [注]	不适用	否

SiC 功率器件生产线建设项目	否	75,000.00	75,000.00	未作分期承诺	44,318.59	44,318.59	-30,681.41	59.09	2025年6月	不适用		否
汽车半导体封装项目(一期)	否	110,000.00	110,000.00	未作分期承诺	-	-	-110,000.00	-	2025年9月	2023年该项目实现销售收入36,994.69万元,实现销售毛利4,722.75万元,实现利润总额-1,259.17万元 [注]	不适用	否
补充流动资金	否	165,000.00	146,306.11	未作分期承诺	146,306.11	146,306.11		100.00		不适用		
合计	—	650,000.00	491,306.11		190,624.70	190,624.70	-300,681.41		—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司2024年2月1日第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51,885.82万元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金150.97万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					无							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目、汽车半导体封装项目（一期）已通过自有资金投入部分设备，具备初步生产能力，正在逐步达产中。

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	截至期末计划累计投入金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
8 吋芯片生产线二期项目	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	30,000.00	未作分期承诺	0.90	30,236.17	100.79	2024 年 12 月	2023 年该项目实现销售收入 92,475.73 万元, 实现销售毛利 14,123.19 万元, 实现利润总额 9,880.60 万元	不适用	否
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目		10,000.00	未作分期承诺	59.61	9,852.47	98.52	2022 年 12 月	2023 年该项目实现销售收入 31,804.04 万元, 实现销售毛利 4,303.02 万元, 实现净利润 2,696.34 万元	否[注]	否
合计	—	40,000.00		60.51	40,088.64	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	详见本核查意见一/（一）/2、/（2）/2）之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目预计正常生产年度新增净利润 4,460 万元，本期未达预计效益主要系本年度下游客户需求结构性调整，产品价格有所下降，同时原材料价格持续高位运行，成本较高，综合导致毛利率下降。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



姜浩



陈俊杰

